



## 半田レスの基板間コネクタ

### 製品概要

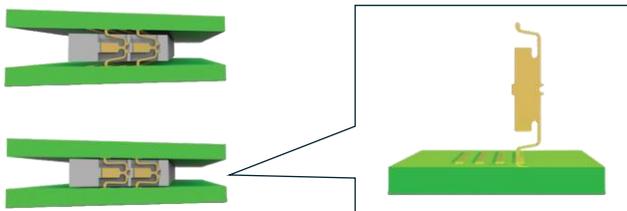


AirBorn社のZシリーズは、高密度基板間接続用コネクタです。

AirBorn社の特許である接触式コンタクトは、基板を上下に挟み込むことで電氣的接続を行い半田付けが不要です。MIL-DTL-55302の耐環境試験に合格しており、航空防衛宇宙向けのアプリケーションに最適です。

また、1つのコネクタで基板間接続を行う為、基板/機器内のスペースの削減や軽量化に貢献できます。複数の厚みのあるボディを用意しており、お客様の機器に適した基板間の距離を実現する事ができます。コネクタの形状やピン数はご要望によりカスタム対応可能です。

### コンタクトシステム



ばねの力を利用した信頼性の高い接触式コンタクトは基板間に確実な導通を提供します。

### 特徴

- 適用規格： MIL-DTL-55302（準拠）
- コネクタの高さ： 0.100inch～0.350inch
- コンタクトピッチ： 0.05inch(1.27mm)
- コネクタタイプ： ストレート
- 配列/極数： 2~7 列 / 列×10~25 コンタクト
- 定格電流： 0.5A(MAX) カスタムで変更可能
- 使用温度範囲： -65°C~ +125°C

